

无锡回收硬盘

产品名称	无锡回收硬盘
公司名称	深圳银源电子
价格	800.00/件
规格参数	品牌:英特尔、三星、金士顿、AMD、希捷 型号:各种型号 产地:进口
公司地址	深圳市福田区华强北街道华航社区振华路100号 深纺大厦C座2K22
联系电话	15338737949 15338737949

产品详情

无锡回收硬盘 厂家经营，终端一站式，收购专家，终端评估 无锡回收硬盘 长期回收各种电子元器件：
报废直插电感、拆机电子料、报废感光芯片、拆板通信主板、车规UFS芯片、拆板英飞凌模块、汽车手机卡座、汽车通信主板、拆板SD卡、拆机18650电池、拆板宏发继电器、汽车LED芯片、拆板手机IC、拆机I3系列CPU、报废瑞昱IC、二手联发科IC、车规镁光内存条、拆板晶闸管、汽车跳舞机、传感器IC、二手钠电池、二手德州仪器IC、东芝芯片、金士顿SD卡、报废单片机、车规江波龙SD卡、拆板电源、拆机海力士芯片、二手蓝牙耳机、汽车镁光IC、二手江波龙内存条、汽车闪迪CF卡、拆板变压器、拆板功率MOS管、二手电子元件、报废音频芯片、报废尼吉康电容、拆板无线芯片、拆机通信芯片、二手平板电脑、拆机三工器、汽车游戏CPU、二手加速计、拆机接插件、报废高通IC、拆机MOS管、拆机闪存芯片、风华高科电容、拆机瑞昱芯片 无锡回收硬盘 长期回收各种电子元器件型号：HD6437105XXXFW、A D8022ARMZ-REEL、ERJ12SF6492U、MIC5301-2.6YD5-TR、LQG15WZ24NG02、HF18FF/A012-4Z53、RFP A1702、MC80F0104、BZX884-B56、SN74LVTH374PW、ERX5SJ5R1H、EXBU28684JX、SN74AS1000AN、E CA1HM222、ERJ8ENF1963V、GRM329R11H123JA01#、16SEQP39M+TSS、B82422H1333J000、XCZU7EG-1FFVF1517E、ERJ3EKF2613V、ERJU6RD1870V、ERJ6DQDR215V、MA4P606-4、CC1206GRNPOABN391、DS90LV032AW-MLS、ERA6VRW1692V、P6KE18A-HF、ATV04A7V5J-HF、BZX84B15LT1G、H5TG43B FR-G7C、SN74AXC1T45QDCKRQ1、GQM1555C2D3R2WB01#、APT23F60B、L99MD02XP、AOZ1373DI-02、TX2SS-3V-TH-Z、LT3506IFE#PBF、MT47H128M8HQ-3E:E、OP490GPZ、6348H、XCVU27P-1SIGD21 04I、LM290SRG4、LM2623AMM/NOPB、ADUM1201CRZ-RL7、LQW15AN9N4J8Z、L297 / 1、LM26003QMH/NOPB、VC-801-EAE-KAAN-40M0000000、CTSR0.6-TP/SP2、MSP6TA-12-12 +、ERJS06D16R0V、ERJU14D1200U、LTC2642ACDD-16#PBF、MT47H64M16NF-25E ES:M、QVS107CG3 R3BCHT、CL21A226MAYNNNR、ERJ8GEYJ430V、MIC5353-3.3YMT-TR、D9KCD、MHQ0402PSA0N900 0、ERJB1AG431U、ERJB2AJ473V、LTC3779IFE#TRPBF、HF116F-1/012DP-1HTFW、GRM21BR71A105MA 01#、LT3015EQ-5#TRPBF、CC0402CRNPO9BN5R0、UPD70F3370AM1GBA-GAH-AX、DCDFD、GRM022 2C1C9R2CA03#、GMD033R71E561KA01#、LM25101AMR/NOPB、TMF105B7222MVHF、NCV21804DTBR 2G、GQM2193C1H2R1BB01#、CC0805JRX7R9BB102、ERG2SGU750V、LQH43NN271J03、532CH1H473J1 60KA、EEEF1A221、ERJU01F3833C、ERA6VPB2741V、SR3W2、LTC1384CSW#PBF、LP5907UVE-3.0/N OPB、5962-9221401M2A、HF32F/048-H、ECEA1VN331UB、XCKU-2SLGB784I、HF116F-3/024AA-2HTW

、TUSB544RNQT、ERJUP8F2700V、ERJ14NF2550U、GRM0332C2A9R7BA01#、ADP5063ACPZ-1-R7、BK P1005EM300-T、W25Q16JVXGIQ、ERJS02F4303X、ERJ6BQF1R6V、ERJB1AJ151U、XMC1302-Q040X0016 CSP(ChipScalePACkage)：芯片级封装，该方式相比BGA同等空间下可以将存储容量提升三倍，是由日本三菱公司提出来的。DIP(DualIn-linePACkage)：双列直插式封装，插装型封装之一，指采用双列直插形式封装的集成电路芯片，体积比较大。MCM(MultiChipModel)：多芯片模块封装，可根据基板材料分为MCM-L，MCM-C和MCM-D三大类。QFP(QuadFlatPackage)：四侧引脚扁平封装，表面贴装型封装之一，引脚通常在100以上，适合高频应用，基材方面有陶瓷、金属和塑料三种。

[厦门回收硬盘](#)